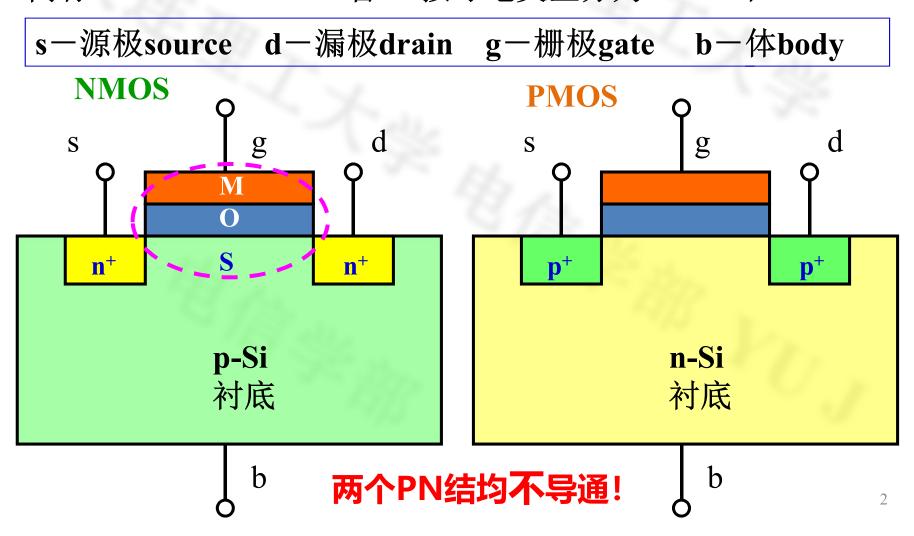
5 场效应管放大电路

- 5.1 MOS场效应晶体管 MOSFET
- 5.2 结型场效应管 JFET
- 5.3 各种场效应管对比
- 5.4 场效应管放大电路
- 5.5 组合放大电路分析

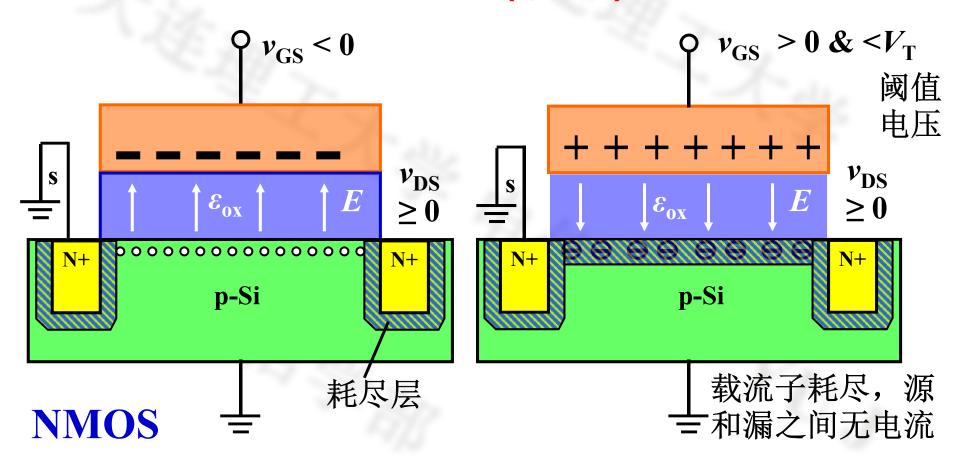
1. 器件结构

MOSFET: Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 简称 MOSFET、MOS管。按导电类型分为NMOS和PMOS。



2. 增强型NMOS的工作原理

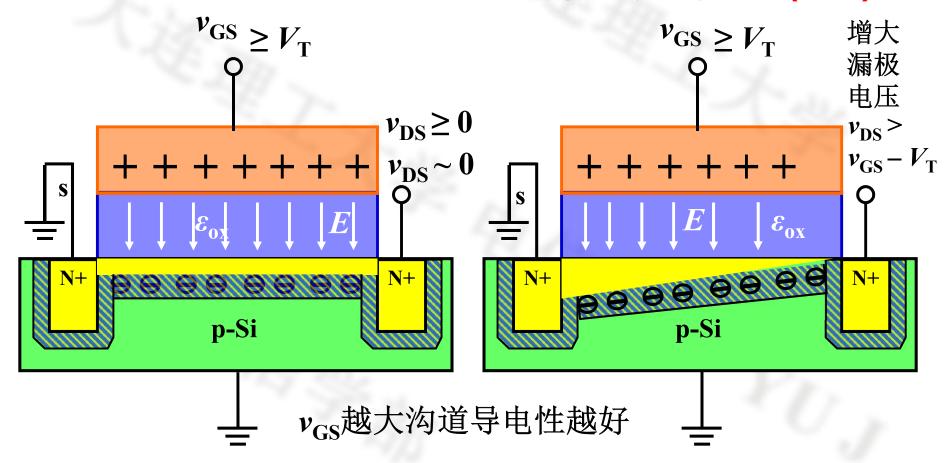
源漏截止 (不导通)



2. 增强型NMOS的工作原理

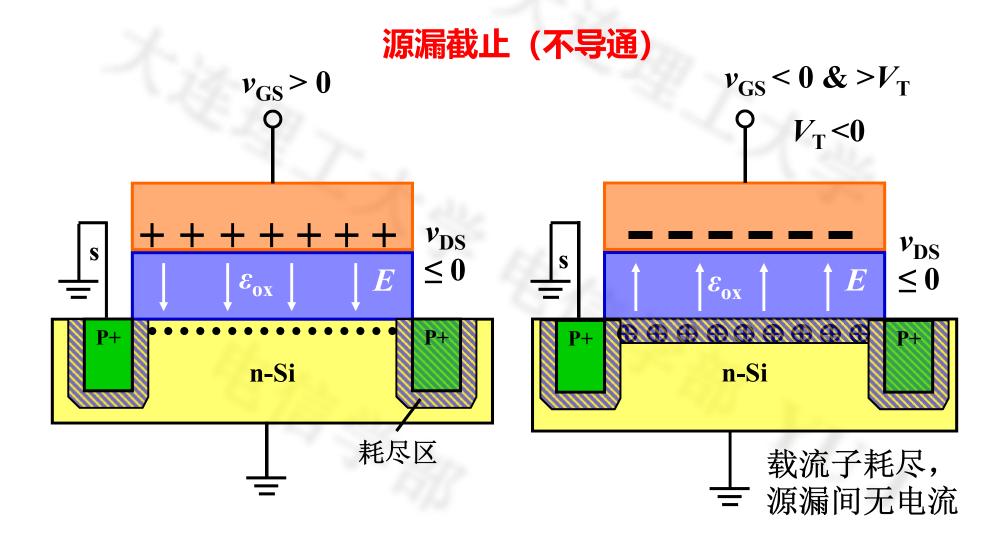
源漏导通,载流子是电子

源极: 提供载流子(电子)



半导体表面电子浓度增大, 形成电子通道-----反型层沟道 漏极附近沟道夹断,沟道导电能力下降(沟道电阻大)

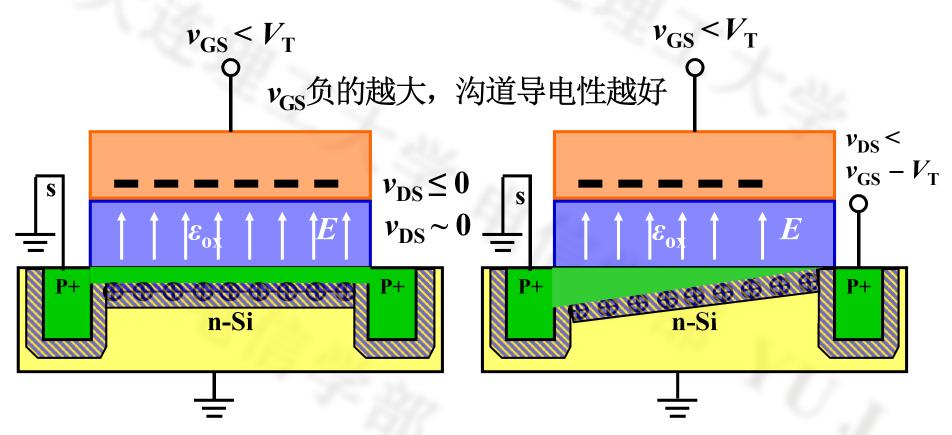
3. 增强型PMOS的工作原理



3. 增强型PMOS的工作原理

源漏导通,载流子是空穴

源极:提供载流子(空穴)

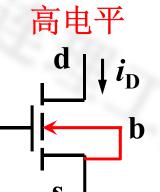


半导体表面空穴浓度增大, 形成空穴通道-----反型层沟道 漏极附近沟道夹断,沟道导电能力下降(沟道电阻大)

4. 增强型MOS管的符号

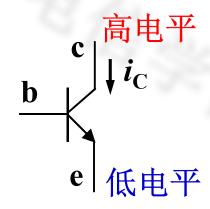
增强型NMOS

变3端: bs短接



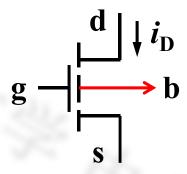
低电平(提供电子)

对比NPN管



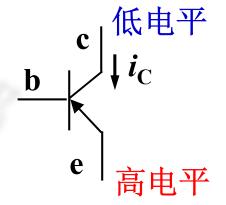
增强型PMOS

低电平



高电平(提供空穴)

对比PNP管



b端箭头:

 $P \rightarrow N$

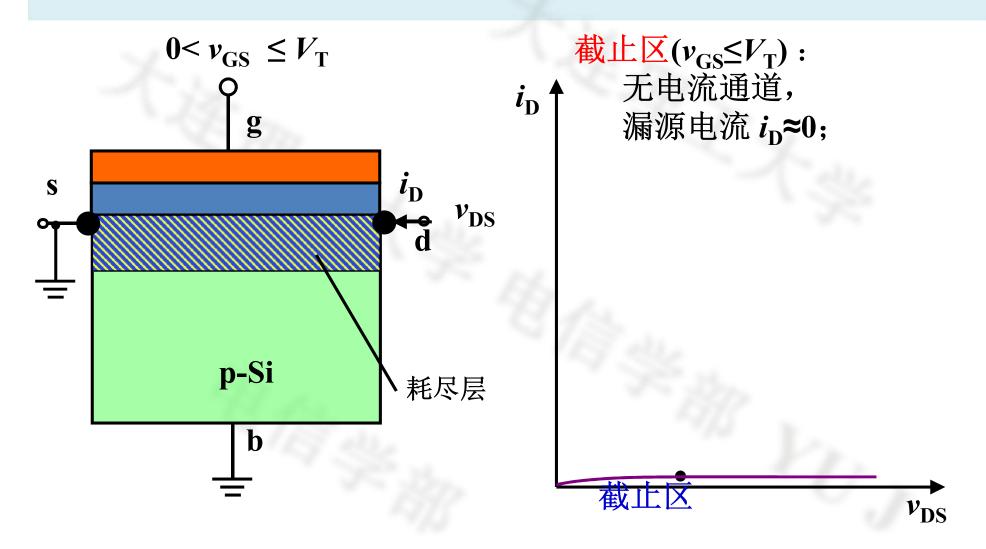
d相当于c

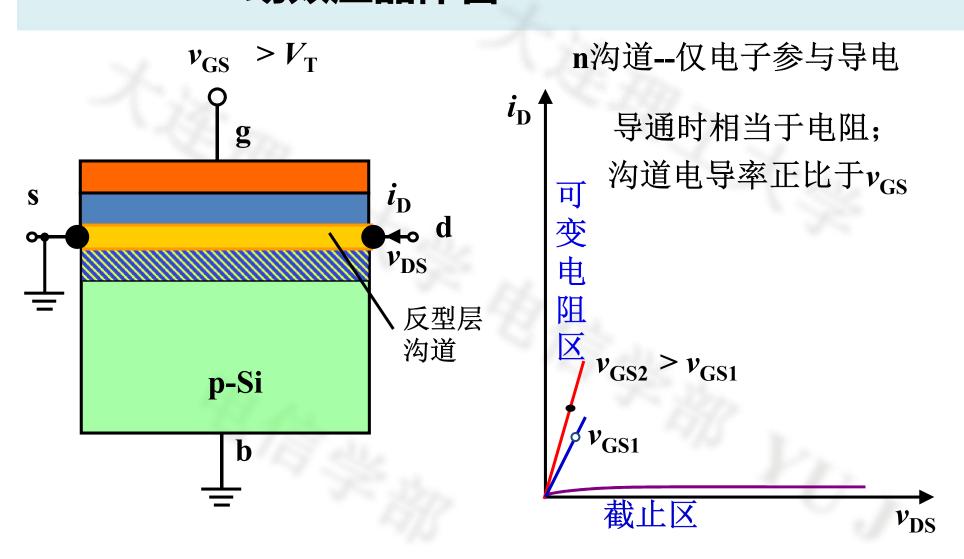
g相当于b

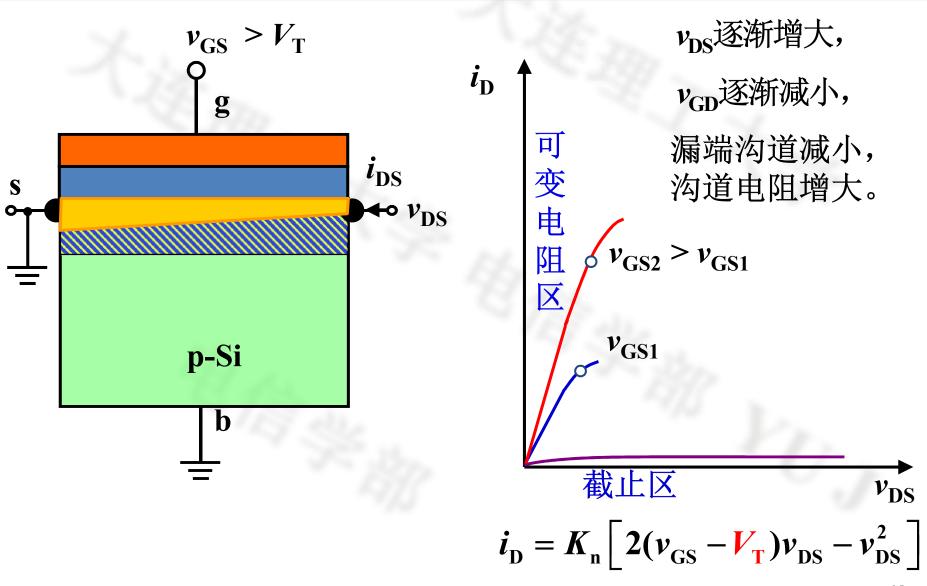
s 相当于e

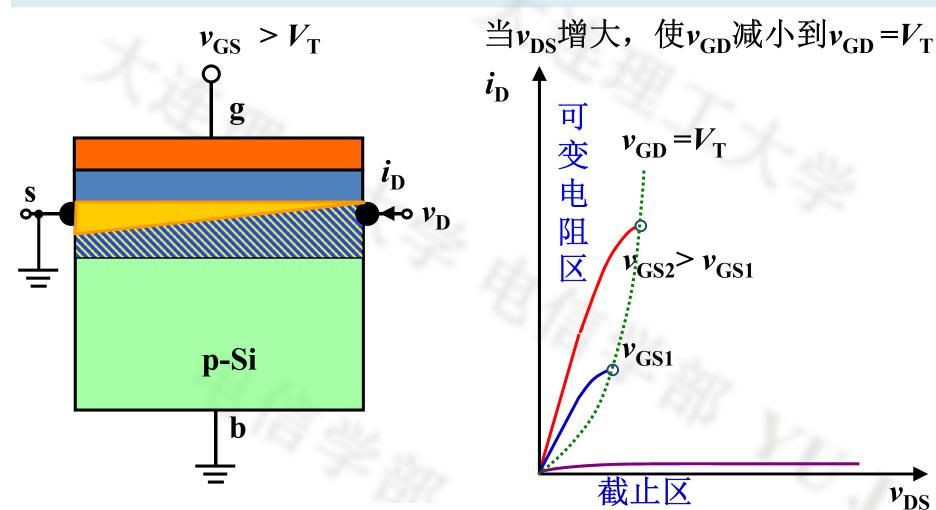
Je箭头:

 $P \rightarrow N$





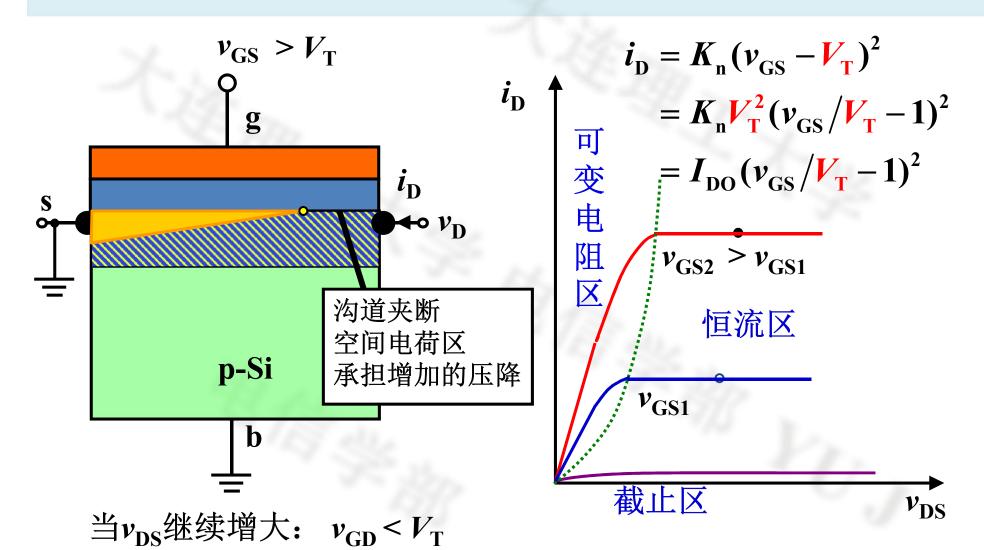




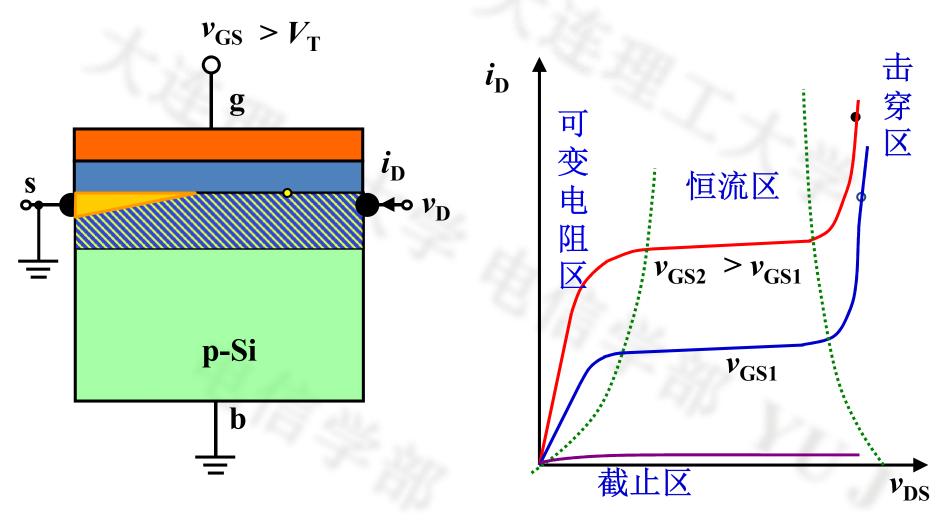
漏极处沟道预夹断 (pinch off)

$$i_{\mathrm{D}} = K_{\mathrm{n}} \left[2(v_{\mathrm{GS}} - V_{\mathrm{T}})v_{\mathrm{DS}} - v_{\mathrm{DS}}^{2} \right]$$

 $v_{
m DS}$

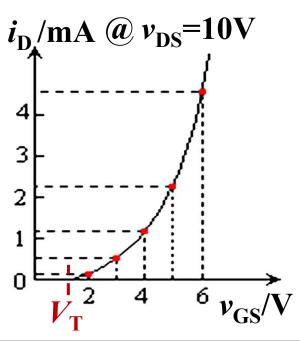


 i_{D} 达到饱和,不再随 v_{DS} 增加,所以也称为"饱和区"。



i_D/mA 预夹断临界点轨迹 中区 6V 电阻 6V 电阻 5V 曲 4V 数上区 0 五十五 0 本 0 五十五 0 本 0 本 0 本 0 本 0 大 0 大 0 大 0

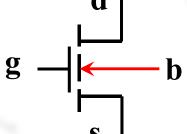
6. 放大区转移特性曲线



$v_{ m GS}$	$v_{\rm DS}$ (>0)	工作区	$i_{ m D}$
$v_{\rm GS} < V_{\rm T}$	任意	截止区	$i_{\mathrm{D}} \approx 0$
$v_{\rm GS} \ge V_{\rm T}$	$v_{\rm DS} < v_{\rm GS} - V_{\rm T}$	可变电阻区	$i_{\mathrm{D}} = K_{\mathrm{n}} \left[2(v_{\mathrm{GS}} - V_{\mathrm{T}})v_{\mathrm{DS}} - v_{\mathrm{DS}}^{2} \right]$
$v_{\rm GS} \ge V_{\rm T}$	$v_{\mathrm{DS}} \ge v_{\mathrm{GS}} - V_{\mathrm{T}}$	恒流区/放大区/ 饱和区	$i_{\rm D} = I_{\rm DO}[v_{\rm GS}/V_{\rm T} - 1]^2$

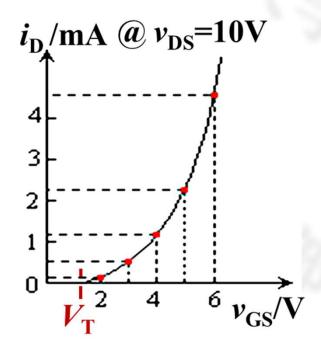
5.1 MOS场效应晶体管 7. 增强型NMOS对比NPN管

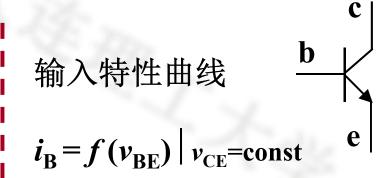
转移特性曲线

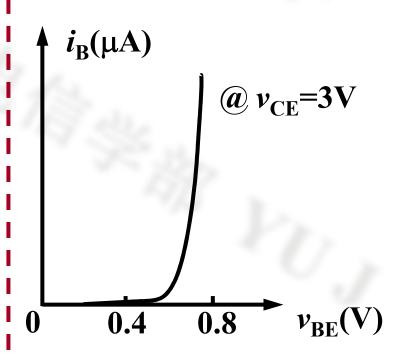


Transfer Characteristics

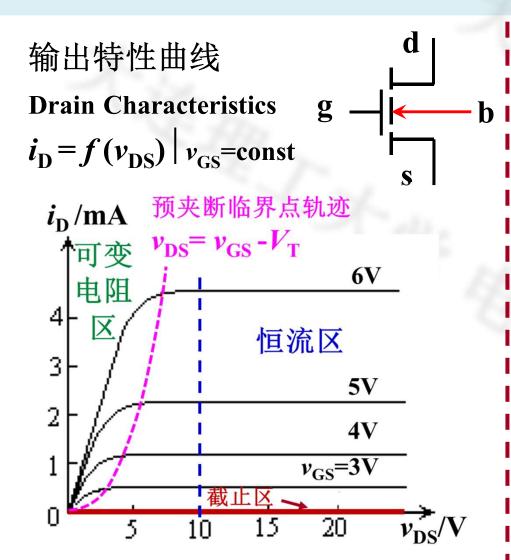
$$i_{\rm D} = f(v_{\rm GS}) \mid v_{\rm DS} = {\rm const}$$



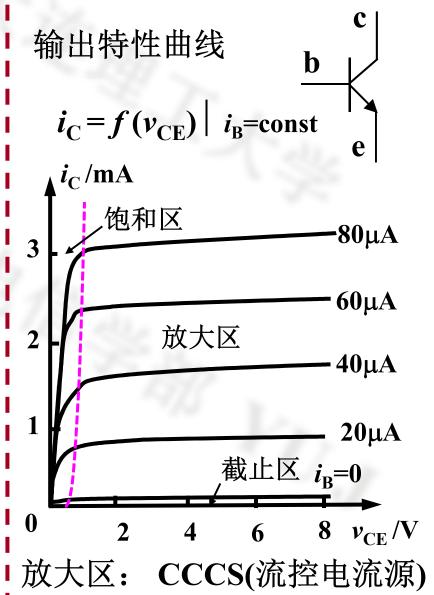




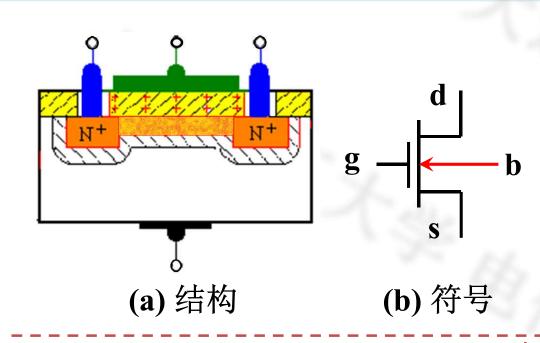
5.1 MOS场效应晶体管 7. 增强型NMOS对比NPN管

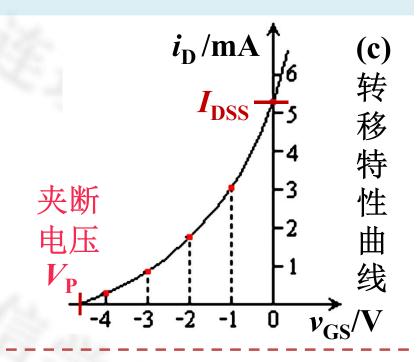


恒流区: VCCS (压控电流源)



8. 耗尽型NMOS管





增强型NMOS (常闭型) 恒流区 $(v_{GS} \ge V_T)$:

$$i_{\rm D} = I_{\rm DO} \left(\frac{v_{\rm GS}}{V_{\rm T}} - 1\right)^2$$

$$I_{\rm DO} = K_{\rm n} V_{\rm T}^2$$

耗尽型NMOS (常开型) 恒流区 $(v_{GS} \ge V_P)$:

$$i_{\rm D} \approx I_{\rm DSS} (1 - \frac{v_{\rm GS}}{V_{\rm P}})^2$$

$$I_{\rm DSS} = K_{\rm n} V_{\rm P}^2$$

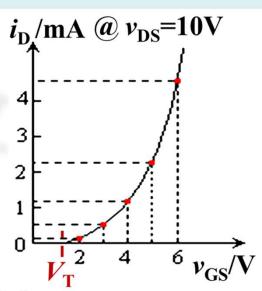
9. 主要参数 (与MOS类型有关,以NMOS为例)

- (1) 直流参数
 - ① $V_{\rm T}$ ___开启电压(增强型) $v_{\rm GS} \leq V_{\rm T}$ 时, $i_{\rm D} \approx 0$ or $V_{\rm P}$ ___夹断电压(耗尽型) $v_{\rm GS} \leq V_{\rm P}$ 时, $i_{\rm D} \approx 0$
 - ② I_{DSS} ___饱和漏极电流(耗尽型) v_{GS} = 0 (shorted) 时所对应的 i_D
 - ③ R_{GS} __直流输入电阻 约 $10^9 \sim 10^{15} \Omega$

9. 主要参数 (与MOS类型有关,以NMOS为例)

(2) 交流参数

① $g_{\rm m}$ ____低频跨导transconductance 反映 $v_{\rm GS}$ 对 $i_{\rm D}$ 的控制作用(VCCS) $g_{\rm m} = \Delta I_{\rm D}/\Delta V_{\rm GS}$ $V_{\rm DS}$ =const (mS) (毫西门子) 恒流区: $g_{\rm m} = 2K_{\rm n}(v_{\rm GS}-V_{\rm T})$

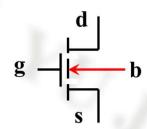


 $g_{\rm m}$ 可以在转移特性曲线上求取,即曲线的斜率

- (3) 安全参数 ①最大漏极电流 I_{DM}
 - ② U_{BRXX} ___击穿电压

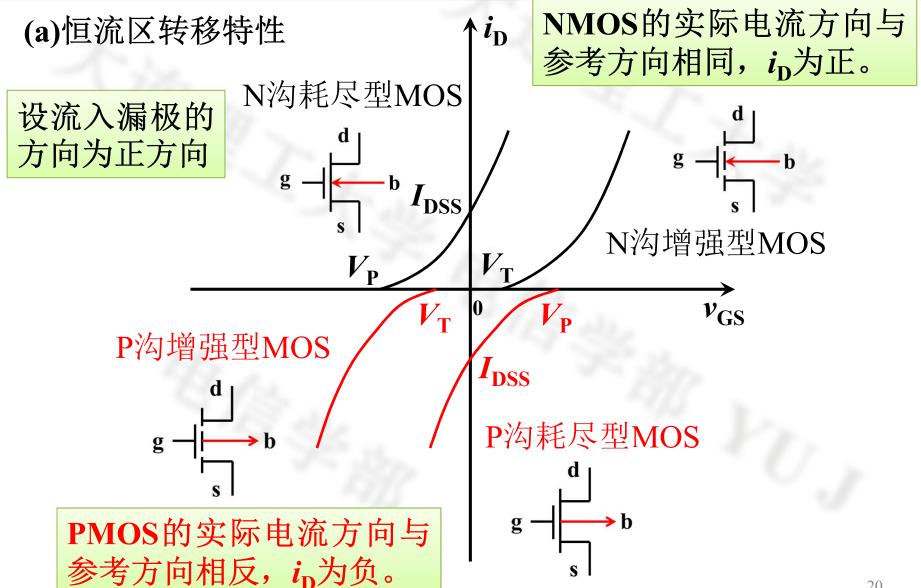
XX: GS, DS

③ P_{DM} 最大漏极功耗 由 $P_{\text{DM}} = v_{\text{DS}} i_{\text{D}}$ 决定



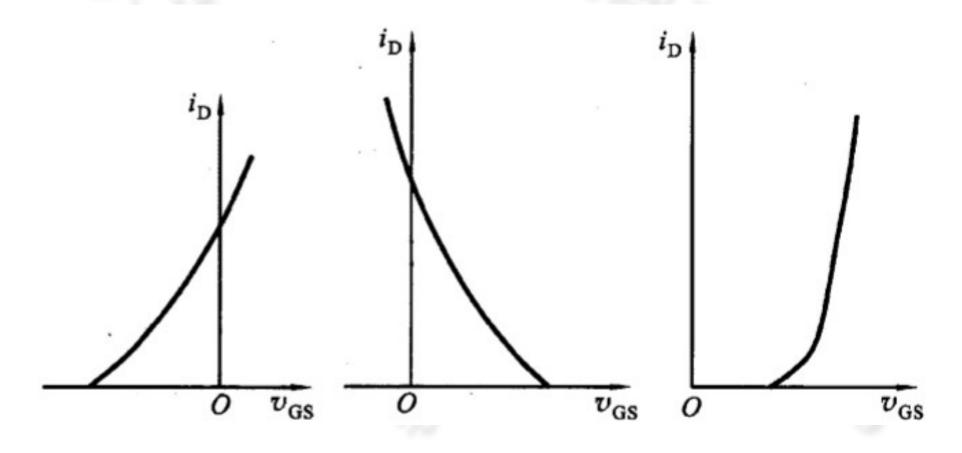
MOS场效应晶体管

10. 伏安特性总结

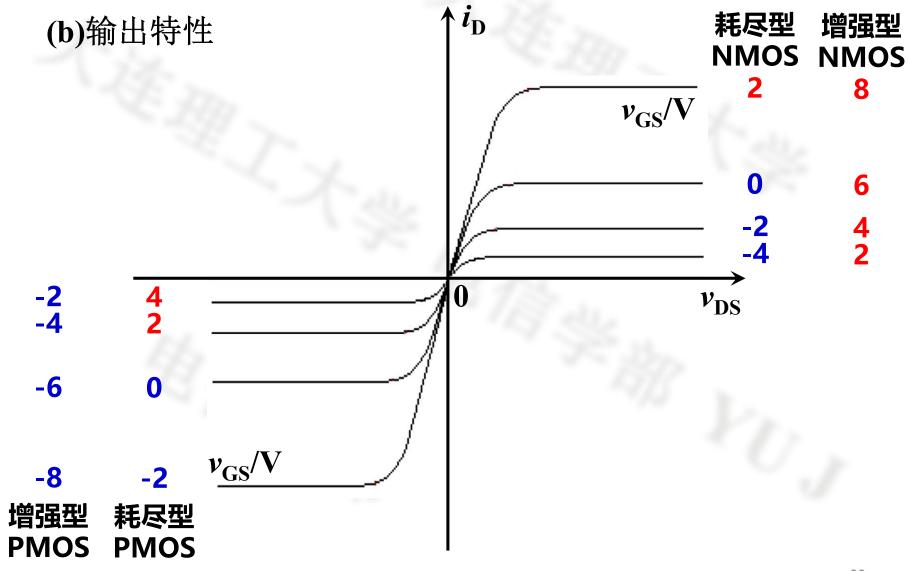


练习

 i_D 的假定正向是它的实际方向。试问它们各是哪种类型的 FET?



5.1 MOS场效应晶体管 10. 伏安特性总结



小结

掌握: 器件符号、转移特性、输出特性

理解: 器件结构和工作原理

预习: 结型场效应管JFET、放大电路

作业

P249: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4

问题?

